

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011年9月1日(01.09.2011)



PCT



(10) 国際公開番号
WO 2011/104905 A1

(51) 国際特許分類:

C08G 59/06 (2006.01) *C08J 5/04* (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) *C08J 5/24* (2006.01)
B32B 27/04 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/063771

(22) 国際出願日: 2010年8月13日(13.08.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願 2010-039388 2010年2月24日(24.02.2010) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 森田 高示 (MORITA, Kouji) [JP/JP]; 〒3088521 茨城県筑西市小川1500番地 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 村井 曜 (MURAI, Hikari) [JP/JP]; 〒3088521 茨城県筑西市小川1500番地 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 高根沢 伸 (TAKANEZAWA, Shin) [JP/JP]; 〒3088521 茨城県筑西市小川1500番地 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 井上 康雄 (INOUE, Yasuo) [JP/JP]; 〒3088521 茨城県筑西市小川1500番地 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 坂井 和永 (SAKAI, Kazunaga) [JP/JP]; 〒3088521 茨城県

筑西市小川1500番地 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 大谷 保, 外(OHTANI, Tamotsu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門三丁目25番2号 ブリヂストン虎ノ門ビル6階 大谷特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: VARNISH, PREPREG, FILM WITH RESIN, METAL FOIL-CLAD LAMINATE, AND PRINTED CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: ワニス、プリプレグ、樹脂付きフィルム、金属箔張積層板、プリント配線板

(57) Abstract: Provided is a varnish obtained by reacting, in a solvent, at least a portion of a functional group, that is contained in a resin having a polycyclic structure and that reacts with an amino group, with the amino group contained in a compound. Also provided is a varnish obtained by reacting, in a solvent, at least a portion of a functional group, that is contained in a resin having a polycyclic structure and that reacts with a phenolic hydroxyl group, with the phenolic hydroxyl group contained in a compound. Additionally, provided are a prepreg, a film with a resin, a metal foil-clad laminate, and a printed circuit board which are obtained by using one of the aforementioned varnishes.

(57) 要約: アミノ基と反応する官能基を有し、かつ多環式構造を含む樹脂の前記官能基の少なくとも一部と、アミノ基を有する化合物の該アミノ基とを溶媒中で反応させて得られるワニス、フェノール性水酸基と反応する官能基を有し、かつ多環式構造を含む樹脂の前記官能基の少なくとも一部と、フェノール性水酸基を有する化合物の該フェノール性水酸基とを溶媒中で反応させて得られるワニスである。また、これらいずれかのワニスを用いて得られる、プリプレグ、樹脂付きフィルム、金属箔張積層板及びプリント配線板である。



WO 2011/104905 A1